

广东生益科技股份有限公司 关于调整公司募集资金投资项目实施进度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司于 2012 年 8 月 24 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于调整公司募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将 LED 用高导热覆铜板项目（松山湖第一工厂第六期）的完成日期由 2012 年 6 月调整至 2013 年 12 月底前。该议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]208 号文《关于核准广东生益科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行普通股（A 股）137,606,016 股，发行价格每股 9.24 元，募集资金总额为人民币 1,271,479,587.84 元。扣除发行费用人民币 33,929,587.84 元后，公司募集资金净额为人民币 1,237,550,000.00 元。该募集资金已于 2011 年 5 月 5 日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具“广会所验字[2011]第 10005350061 号”《验资报告》。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用计划

经公司第六届第八次董事会和 2010 年第一次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票扣除发行费用后募集资金净额将全部用于投资以下项目：

项目	项目投资总额（万元）	项目建设期
软性光电材料产研中心项目（松山湖第一工厂第四期）	27,965	3 年
高性能刚性覆铜板和粘结片技术改造项目（松山湖第一工厂第五期）	70,790	2 年
LED 用高导热覆铜板项目（松山湖第一工厂第六期）	25,000	2 年
合计	123,755	-

（二）募集资金实际使用情况

截至 2012 年 6 月 30 日，公司软性光电材料产研中心项目（松山湖第一工厂第四期）累计投资 21,868.82 万元，投入进度 78.20%；高性能刚性覆铜板和粘结片技术改造项目（松山湖第一工厂第五期）

累计投资 61,884.47 万元，投入进度 87.42%；LED 用高导热覆铜板项目（松山湖第一工厂第六期）累计投入金额为 2,506.23 万元，投入进度为 10.02%。

单位：万元

投资项目	承诺投入金额	累计投入金额	投入进度	预计可达使用状态日期
软性光电材料产研中心项目 (松山湖第一工厂第四期)	27,965	21,868.82	78.20%	已试产，但未达产
高性能刚性覆铜板和粘结片 技术改造项目(松山湖第一工厂第五期)	70,790	61,884.47	87.42%	已试产，但未达产
LED 用高导热覆铜板项目(松山湖第一工厂第六期)	25,000	2,506.23	10.02%	2013 年 12 月投入试生产

(三) 募集资金投资项目延期原因

LED 用高导热覆铜板项目（松山湖第一工厂第六期）预定投产日期为 2012 年 6 月，但截至 2012 年 7 月 31 日，募集资金实际投入金额为 2,506.23 万元，投入进度为 10.02%，投入进度慢于预期。该募投资项目延期原因如下：

近两年来，LED 产业发展迅猛，投资强度较大，但同时也暴露出行业无序竞争、相关标准未定、终端厂家为了降低成本对高导热覆铜板等辅助材料使用混乱等状况。本公司已经推出在国内具备优良导热性能的高导热覆铜板产品，但市场接受认证认知的过程慢于公司的预期，公司也在根据市场的需要研发更具市场竞争力的高导热系列化产品。我们继续看好 LED 市场发展前景，LED 用高导热覆铜板产品应用市场将逐步规范，针对 LED 不同设计用途的高导热覆铜板将呈现系列化产品，我们认为 LED 用高导热产品仍具有较好的市场前景和盈利潜能。

另外，随着电子元器件的小型化和轻薄化，去年至今许多 PC 厂家都在主攻“超薄本”技术，大有替代传统 PC 产品的趋势，由此带来覆铜板导热性能的新要求，我们推迟原定的导热基材项目，也是希望调整原定只用于 LED 的导热基材项目，增加一些高性能的导热覆铜板技术，以满足市场的新需求。这些项目因为设备和技术都比较新颖，从对投资者负责任的角度考虑，我们可能分阶段实施。

公司本着对投资者负责的态度，为降低募集资金的投资风险，公司管理层一直采取审慎的态度合理规划募投资项目投资进度，力求募集资金效益最大化。公司根据高导热覆铜板产品市场的变化，主动控制项目设备投资进度，因此该项目实施进度将慢于原来预期进度。

三、调整募集资金投资项目实施进度的具体内容

鉴于以上原因，公司拟调整 LED 用高导热覆铜板项目（松山湖第一工厂第六期）的完成日期，经公司谨慎测算，该募投项目完成日期由 2012 年 6 月调整至 2013 年 12 月底之前。

四、调整募集资金投资项目实施进度对公司生产经营的影响

本次拟调整实施进度的 LED 用高导热覆铜板项目（松山湖第一工厂第六期）投资总额 25,000 万元，已经使用金额 2,506.23 万元，占募集资金投资总额的 10.02%，尚未使用金额为 22,493.77 万元。公司通过对旧线小的技改投入，使该旧线改造后的产能能满足市场小批量高导热产品的供应，因此调整该募投项目的实施进度，对公司目前生产经营影响较小。公司将本着对股东高度负责的精神，采取审慎的态度，根据外部市场环境情况，科学合理地对募投项目进行规划，长远看有利于该募集资金投资项目的效益最大化，更有利于公司长远发展。

五、相关审核及批准程序

（一）公司于 2012 年 8 月 24 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《广东生益科技股份有限公司关于调整公司募集资金投资项目实施进度的议案》。

（二）公司于 2012 年 8 月 24 日召开的第七届监事会第三次会议审议通过了《广东生益科技股份有限公司关于调整公司募集资金投资项目实施进度的议案》。认为：公司此次调整 LED 用高导热覆铜板项目（松山湖第一工厂第六期）实施进度，没有违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定，程序合法有效，符合公司实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次调整对公司目前生产经营影响较小，结合市场情况，经过更为谨慎地规划，长期看有利于实现募投项目效益最大化，更有利于公司长远发展。因此同意公司对 LED 用高导热覆铜板项目（松山湖第一工厂第六期）的完成日期由 2012 年 6 月调整至 2013 年 12 月底之前。

（三）公司独立董事发表意见，认为：公司根据外部市场情况和项目建设实际进度，科学审慎地调整 LED 用高导热覆铜板项目（松山湖第一工厂第六期）实施进度，有利于公司控制经营风险，实现募投项目效益最大化。本次对募集资金投资项目进度的调整是根据市场环境变化和未来前景的预测及项目建设的实际进度采取的，不存在募集资金投资项目的变更，也不存在损害股东利益的情形。本次调整对公司目前生产经营影响较小，结合市场情况，经过更为谨慎地规划，长期看有利于实现募投项目效益最大化，更有利于公司长远发展。因此同意公司对 LED 用高导热覆铜板项目（松山湖第一工厂第六期）的完成日期由 2012 年 6 月调整至 2013 年 12 月底之前。

（四）公司保荐机构东莞证券有限责任公司发表核查意见，认为：生益科技调整 LED 用高导热覆铜板项目（松山湖第一工厂第六期）实施进度是根据项目市场需求的实际情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形；生益科技《关于调整公司募集资金投资项目实

施进度的议案》已履行了相关程序，经生益科技召开的第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。该议案的审议程序符合《公司章程》、《公司募集资金管理制度》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和有关法律法规的规定。东莞证券同意生益科技 LED 用高导热覆铜板项目（松山湖第一工厂第六期）调整投资进度事项。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第三次会议决议；
- 3、公司独立董事关于调整公司募集资金投资项目实施进度的独立意见；
- 4、东莞证券有限责任公司关于广东生益科技股份有限公司调整募集资金投资项目实施进度的核查意见。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董 事 会

2012年8月28日

东莞证券有限责任公司
关于广东生益科技股份有限公司
调整募集资金投资项目实施进度的核查意见

东莞证券有限责任公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为广东生益科技股份有限公司（以下简称“生益科技”或“公司”）2010 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，对生益科技调整公司募集资金投资项目实施进度的情况进行了审慎核查，具体情况如下：

经中国证监会证监许可[2011]208 号文《关于核准广东生益科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行普通股（A 股）137,606,016 股，发行价格每股 9.24 元，募集资金总额为人民币 1,271,479,587.84 元。扣除发行费用人民币 33,929,587.84 元后，公司募集资金净额为人民币 1,237,550,000.00 元。该募集资金已于 2011 年 5 月 5 日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具“广会所验字[2011]第 10005350061 号”《验资报告》。

经公司第六届第八次董事会和 2010 年第一次临时股东大会审议通过，2010 年度非公开发行股票扣除发行费用后募集资金净额将全部用于投资以下项目：

项目	项目投资总额（万元）	项目建设期
松山湖第一工厂（第四期）软性光电材料产研中心项目	27,965	3 年
高性能刚性覆铜板和粘结片技术改造项目（松山湖第一工厂第五期）	70,790	2 年
LED 用高导热覆铜板项目（松山湖第一工厂第六期）	25,000	2 年
合计	123,755	-

其中 LED 用高导热覆铜板项目（松山湖第一工厂第六期）预定投产日期为 2012 年 6 月，但截至 2012 年 6 月 30 日，募集资金实际投入金额为 2,506.23 万元，投入进度为 10.02%，投入进度慢于预期。

LED用高导热覆铜板项目（松山湖第一工厂第六期）出现延期的原因主要如下：

近两年来，LED产业发展迅猛，投资强度较大，但同时也暴露出行业无序竞争、相关标准未定、终端厂家为了降低成本对高导热覆铜板等辅助材料使用混乱等状况。公司已经推出在国内具备优良导热性能的高导热覆铜板产品，但市场接受认证认知的过程慢于公司的预期，公司也在根据市场的需要研发更具市场竞争力的高导热系列化产品。公司继续看好LED市场发展前景，LED用高导热覆铜板产品应用市场将逐步规范，针对LED不同设计用途的高导热覆铜板将呈现系列化产品，公司认为LED用高导热产品仍具有较好的市场前景和盈利潜能。

另外，随着电子元器件的小型化和轻薄化，去年至今许多PC厂家都在主攻“超薄本”技术，大有替代传统PC产品的趋势，由此带来覆铜板导热性能的新要求，公司推迟原定的导热基材项目，也是希望调整原定只用于LED的导热基材项目，增加一些高性能的导热覆铜板技术，以满足市场的新需求。这些项目因为设备和技术都比较新颖，从对投资者负责的角度考虑，公司可能分阶段实施。

公司本着对投资者负责的态度，为降低募集资金的投资风险，公司管理层一直采取审慎的态度合理规划募投项目投资进度，力求募集资金效益最大化。公司根据高导热覆铜板产品市场的变化，主动控制项目设备投资进度，因此该项目实施进度将慢于原来预期进度。

基于以上，生益科技拟将LED用高导热覆铜板项目（松山湖第一工厂第六期）投产日期由2012年6月调整至2013年12月底之前。东莞证券经核查后认为：生益科技调整LED用高导热覆铜板项目（松山湖第一工厂第六期）实施进度是根据项目市场需求的实际情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形；生益科技《关于调整公司募集资金投资项目实施进度的议案》已履行了相关程序，经生益科技召开的第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。该议案的审议程序符合《公司章程》、《公司募集资金管理制度》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和有关法律法规的规定。东莞证券同意生益科技LED用高导热覆铜板项目（松山湖第一工厂第六期）调整投资进度事项。

（此页无正文，为《东莞证券有限责任公司关于广东生益科技股份有限公司调整募集资金投资项目实施进度的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

姚根发

吕晓曙

东莞证券有限责任公司

2012年8月24日